

## 文一三佳科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为便于广大投资者更加全面深入了解文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司于 2024 年 12 月 4 日（星期三）上午 9:00—10:00 在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络文字互动形式召开了 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者就上述事项进行网络互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者关注的问题进行了回答和说明。现将有关情况公告如下：

### 一、本次说明会召开情况

公司已于 2024 年 10 月 23 日通过公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《文一科技关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预告公告》（临 2024-050）。2024 年 12 月 4 日上午，公司董事长杨林先生，董事总经理丁宁先生，副董事长、常务副总经理、财务总监胡凯先生，独立董事储昭碧先生，董事会秘书夏军先生出席了本次业绩说明会，针对公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

### 二、本次说明会投资者提出的问题及公司回复情况

本次业绩说明会，公司就本次会上投资者提出的主要问题及预征集的问题给予了回答。现将本次业绩说明会提出的主要问题及答复情况整理如下：

1、**预征集问题：**请问合肥国资入主公司的进展如何，控股股东的股票解质押进展？

**回复：**据了解，截止目前，“合肥国资入主公司”该权益变动事项现处于有权国资部门审批流程中，该事项能否最终完成实施及完成时间尚存在不确定性。本次权益变动涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

关于控股股东的股票解质押进展情况，目前我公司控股股东正与质权人商谈股票解质押事宜。公司将持续关注相关事项的进展，并根据有关规定及时履行信息披露义务。

**2、预征集问题：**文一科技曾在 2023 年半年报中介绍，针对先进封装技术的进步和市场需求的增加，公司正在研发满足先进封装（晶圆级封装）用模具和设备。在 2023 年年报、2024 年半年报，文一科技并未对扇外型晶圆级封装产品研发进展进行披露。请问扇外型设备的研发进展进度怎样了？

**回复：**公司扇外型晶圆级封装设备第一阶段已研发完成，即第一台手动样机已研发完成。后续研发还有很多难关需要解决且存在不确定性，主要受限于技术因素和市场因素不确定的影响。截止目前，针对该设备的研发进展，我公司未有应披露而未披露信息。

**3、预征集问题：**公司为合肥文一半导体购买的商办楼预计何时投入正式使用，将用来具体研发的项目是什么？公司在合肥购置 2000 平方米的办公楼层，未来是否将研发重心转移至合肥，迎合合肥国资入主的需求？

**回复：**我公司全资子公司文一三佳（合肥）半导体有限公司（以下简称“文一半导体”）购买的商办楼于 2024 年 11 月 12 日刚办理完交房手续，何时投入正式使用将根据我公司具体经营情况确定。

文一半导体购买该商办楼的目的是出于文一科技研究院（2023 年 10 月 27 日经公司董事会批准设立）、文一半导体的实际经营办公场所长远需求考虑的，将依托于安徽省合肥市区域优势，更好的与高校、科研院所开展技术合作、提升公司研发能力，

也更便于招募研发人才、留住人才、稳定人才队伍。

该交易决策是于 2024 年 2 月 4 日公司第八届董事会第十七次会议审议通过的，而合肥市创新科技风险投资有限公司（以下简称“合肥创新投”）以协议受让的方式收购三佳集团、瑞真商业合计持有文一科技 26,993,865 股普通股股份（占文一科技总股本的 17.04%）的事项，即所谓“合肥国资入主”事项发生在 2024 年 10 月 15 日。该交易决策时，“合肥国资入主”事项尚未开始筹划，不存在“迎合合肥国资入主的需求”一说。

**4、预征集问题：**近日，《每日经济新闻》记者前往文一半导体注册地址，注意到该地点无人办公与生产，公司此前称是合肥工厂的地址，请问该工厂何时投入生产，将用于生产什么产品，在该注册地外立面有“人形机器人产业基地”字样，是否未来公司会进军人形机器人领域。

**回复：**文一三佳（合肥）半导体有限公司（以下简称“文一半导体”）主要围绕我公司主营产品及新品而做的项目研发工作。该公司经营范围为半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；人工智能硬件销售；工业机器人制造；工业机器人销售，机械设备研发；机械设备销售等。其所租赁场所之外立面的“人形机器人产业基地”字样并非我公司设置。文一半导体租赁地址尚未启用，文一半导体的人员暂时在铜陵上市公司总部办公。截止目前，我公司没有进军人形机器人领域的计划。

**5、预征集问题：**贵司中远期是否还有并购设想？

**回复：**截至目前，公司暂未有并购计划。

**6、投资者提问：**请问公司在目前市场环境下有哪些技术优势，目前的市场表现如何？

**回复：**我公司致力于用国产装备助力于中国制造，创造价值、贡献社会。在半导体封装模具及设备领域深耕 30 余年，紧贴市场发展新趋势，研发新产品、新技术。公司目前研发的新技术包括但不限于能在玻璃基板上进行芯片先进封装等相关技术、

面板级扇出型晶圆封装等相关技术的研究，等等。截止目前，公司拥有专利约 140 件，其中发明专利约 70 件。公司技术研发实力较为深厚，是国产半导体封装模具及设备领域的重要供应商。有关公司技术方面的其它优势，请参考公司以往披露的定期报告。

**7、投资者提问：**请问公司在封装领域是否有布局？

**回复：**公司将继续聚焦主业，我公司主营业务为半导体集成电路封装模具及设备板块、化学建材挤出模具及设备板块、精密零部件板块等三大板块。

### 三、其他说明

关于本次业绩说明会的全部具体内容，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看。非常感谢各位投资者参加公司本次业绩说明会。在此，公司对关注和支持公司发展并积极提出意见和建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月四日